



# GLASBEARBEITUNG

Ansprechpartnerin  
Antje Oßmann

## LEISTUNGSMERKMALE

- Ultrakurzpuls Laser Schneiden, Bohren, Filamentieren, Abtragen & Strukturieren von Gläsern, Saphir und transparenter Keramik
- Schneiden von Quarzglas mit feuerpolierten Kanten
- keine Gratbildung oder Schmelzanhaftung, kaum Nachbearbeitung bei lose aufliegenden Schmauchpartikeln
- extrem hohe Reproduzierbarkeit
- typische Konizität beim Bohren ca. 1/3 der Materialstärke  
> senkrechte Bohrungen oder Hinterschneidungen (auf Anfrage)
- kontrastreiche Laserbeschriftung von Klartext, Seriennummern, DMC Codes

## BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- unterschiedliche Laserquellen/Anlagen von CO<sub>2</sub> bis Ultrakurzpuls Laser mit Wellenlängen von 10.600 nm, 1.030 nm (IR), 515 nm (Grün), 355 nm (UV)
- minimale Fokusgrößen bis < 25 µm, Genauigkeiten von +/- 20 µm (Strukturierungen) und +/- 50 µm (Bohren, Schneiden & Filamentieren)
- Bearbeitungsraum von 400 x 500 mm<sup>2</sup>
- Materialstärken von dünnsten Gläsern (< 20 µm) bis 3 mm
- automatische Bilderkennung von Positionsmerkmalen

## MATERIALIEN

- Quarzglas
- Borosilikatgläser, D 263®
- Saphir, Spinell
- transparente Keramik
- Kalk-Natron Gläser
- weitere optisch transparente Materialien

## TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Interposer, Durchkontaktierungen
- Fenster für optische Komponenten
- Konfektionierung von Substratmaterialien für Halbleitertechnologie
- Vereinzeln von Mikrobauteilen auf transparenten Substraten
- Kavitäten und Kanalstrukturen für Mikrofluidikanwendungen
- Einbringen von Sollbruchstellen zur späteren Vereinzeln
- gezieltes mattieren von transparenten Oberflächen für Optikanwendungen

*Vielfalt in Material und Anwendung.*

T +49 (0) 36601 9327-54 | vertrieb@lcp GmbH.de